

2025年3月期

決算説明会

2025/05/26



旭ダイヤモンド工業株式会社

01

2025年3月期決算の概要

02

2026年3月期の見通し

03

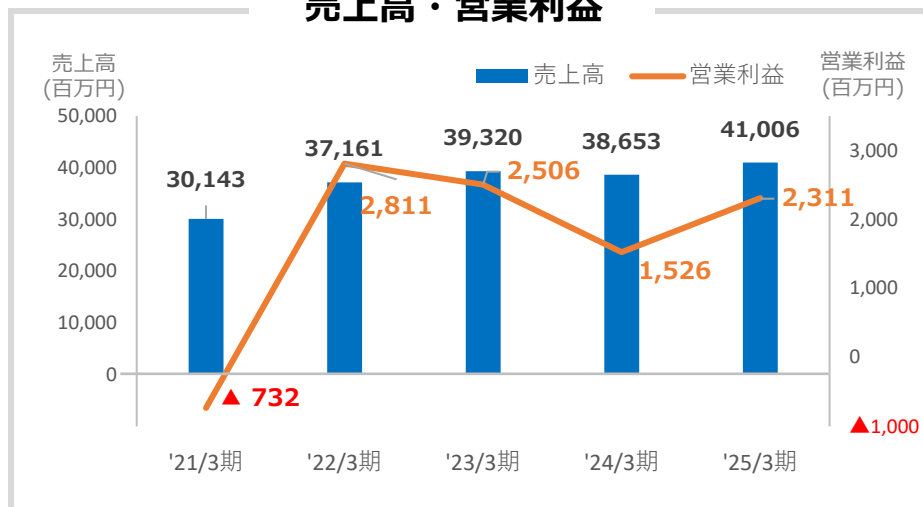
中期経営計画の進捗

決算概要（連結）

前期に対して、売上増加及び収益性の改善により利益は大幅に増加

	'24年3月期		'25年3月期			
	実績	百分比 %	実績	百分比 %	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
売上高	38,653	100.0	41,006	100.0	2,352	6.1
営業利益	1,526	4.0	2,311	5.6	784	51.4
経常利益	2,408	6.2	3,070	7.5	662	27.5
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,109	5.5	2,493	6.1	383	18.2
1株あたり純利益(円)	40.57	-	48.36	-	7.79	-

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

増加要因

- 売上の増加 16億円
- 退職給付費用の減少 3億円

減少要因

- 人件費の増加 7億円
- 償却費の増加 3億円
- 変動費率の増加 2億円

四半期別実績推移（連結）

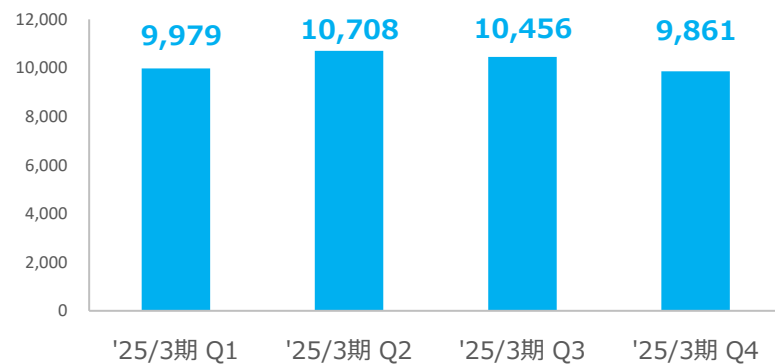
4Qは売上の減少に加えて、償却費等の費用増により利益率が低下

単位：百万円

	'25年3月期							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%
売上高	9,979	100.0	10,708	100.0	10,456	100.0	9,861	100.0
営業利益	547	5.5	752	7.0	809	7.7	202	2.1
経常利益	939	9.4	689	6.4	995	9.5	445	4.5
親会社株主に 帰属する当期純利益	802	8.0	326	3.1	1,029	9.8	334	3.4

売上高（四半期）

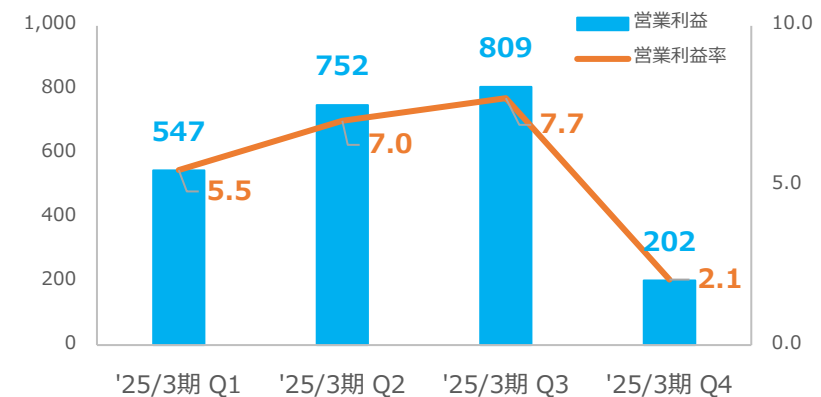
単位：百万円



営業利益（四半期）

単位：百万円

単位：%



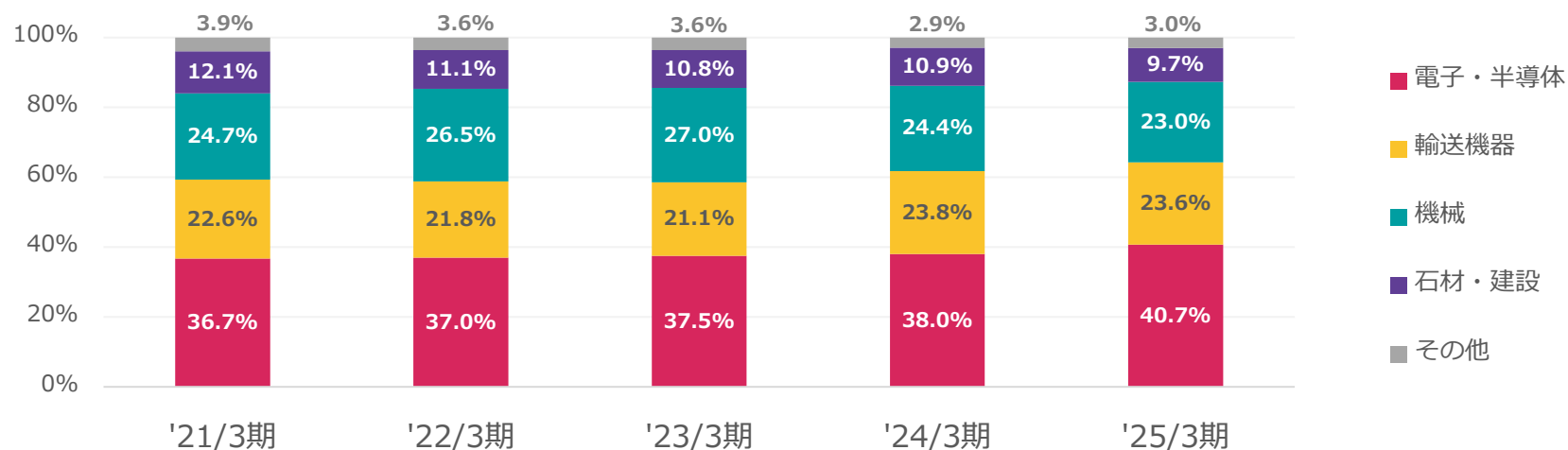
業界別売上高 及び 構成比（連結）

注力している電子・半導体業界の構成比が増加

単位：百万円

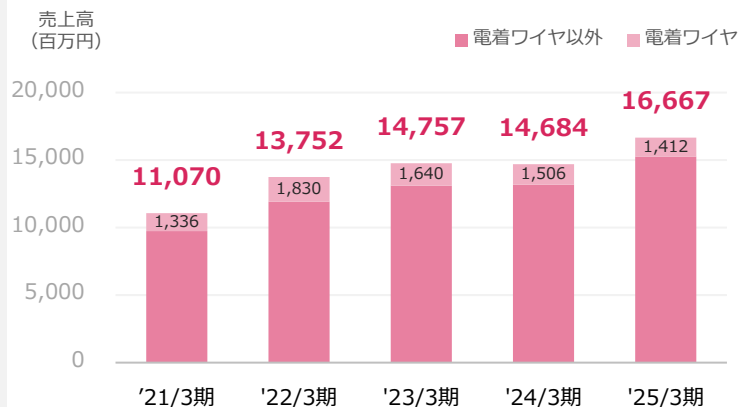
	'24年3月期		'25年3月期			
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 電子・半導体	14,684	38.0	16,667	40.7	1,982	13.5
■ 輸送機器	9,204	23.8	9,692	23.6	488	5.3
■ 機械	9,434	24.4	9,430	23.0	▲4	▲0.0
■ 石材・建設	4,218	10.9	3,975	9.7	▲242	▲5.8
■ その他	1,111	2.9	1,240	3.0	128	11.6
合計	38,653	100.0	41,006	100.0	2,352	6.1

構成比



業界別売上高：①電子・半導体（電着ダイヤモンドワイヤ含む）

通期



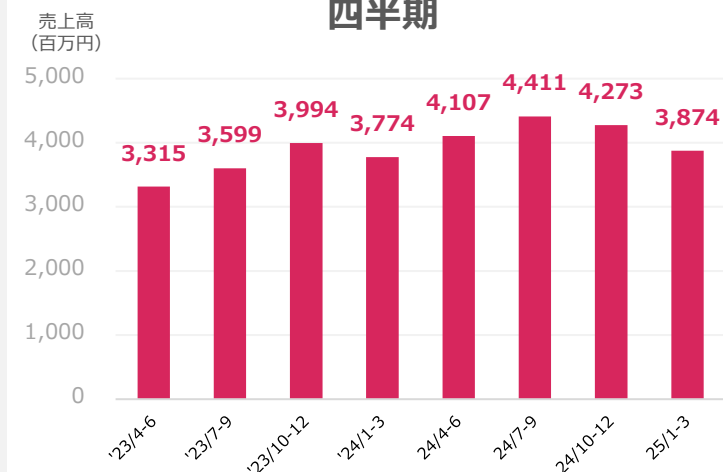
半導体・電子部品

SiC半導体が減少したものの、
先端半導体の需要増により、販売が増加

FPD（フラットパネルディスプレイ）

前期からの回復基調で進捗し、
販売が増加

四半期



伸線

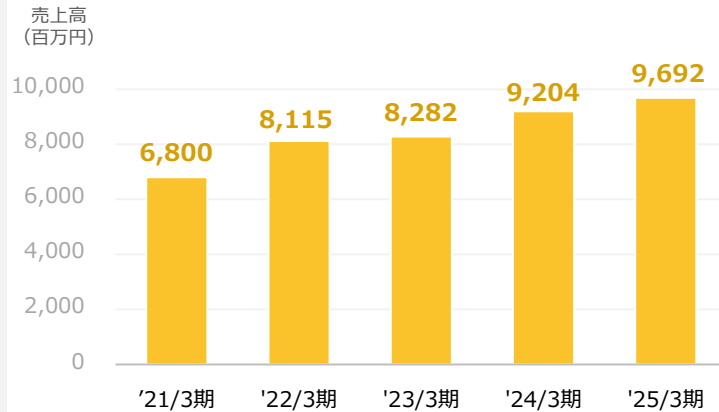
前期からの回復基調で進捗し、
販売が増加

電着ダイヤモンドワイヤ

シリコン向けは増加したものの、
全体では販売が減少

業界別売上高：②輸送機器

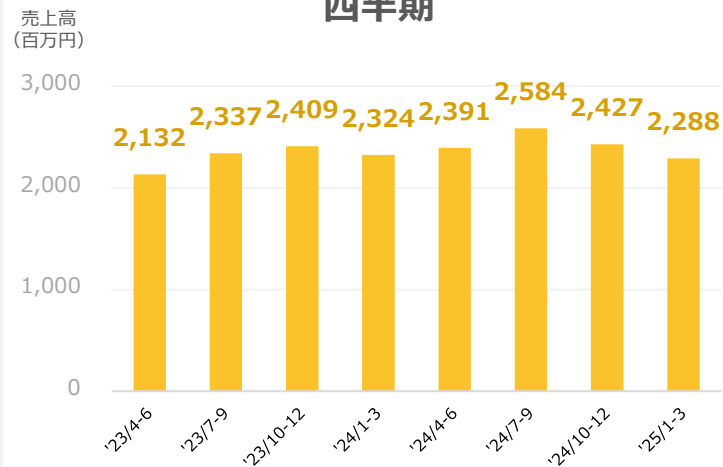
通期



自動車

インドや中米の需要増、商用車向けを中心に販売が増加

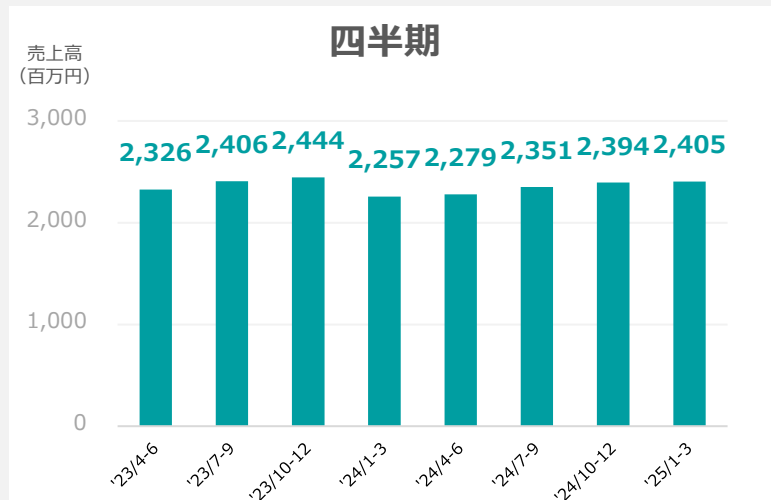
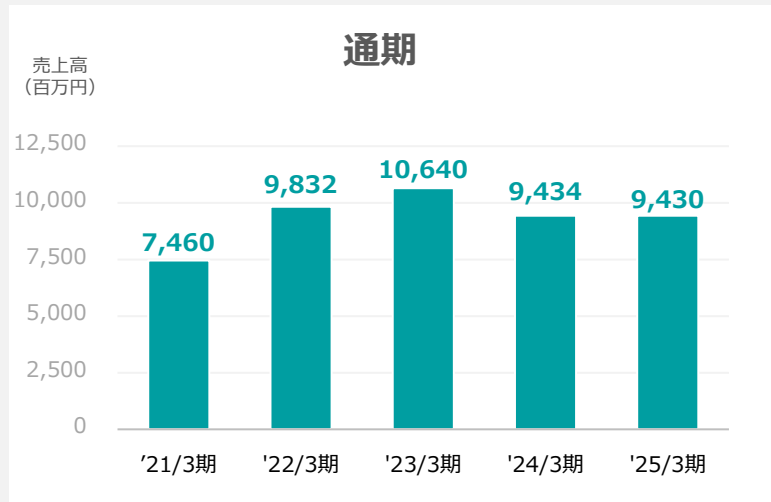
四半期



航空機

需要の回復により販売が増加

業界別売上高：③機械



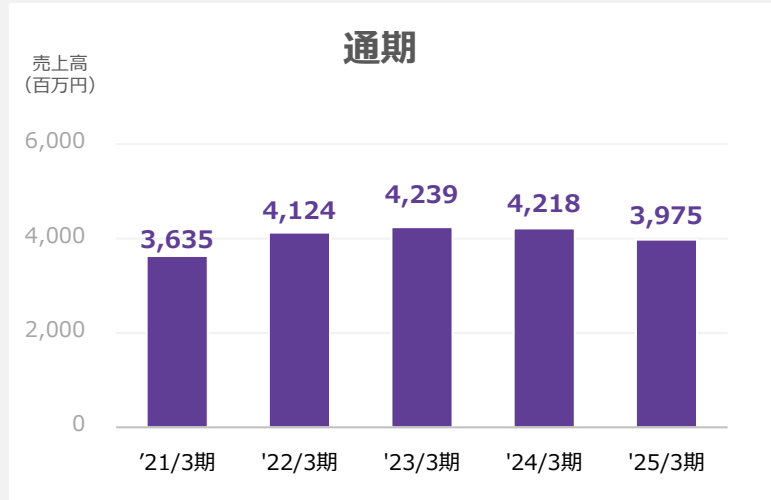
軸受・超硬工具

軸受・超硬工具共に
回復基調で進み、販売が増加

工作機械

工作機械の需要低迷により販売が減少
ただし、半導体装置用セラミック業種向けは増加

業界別売上高：④石材・建設



資源探査

海外の受注が減少し、販売が減少

国内建設

公共工事は堅調であったが、
民間工事や解体工事減少で販売が減少

流通商品(ポータブルカッタ)

販売は前期並み

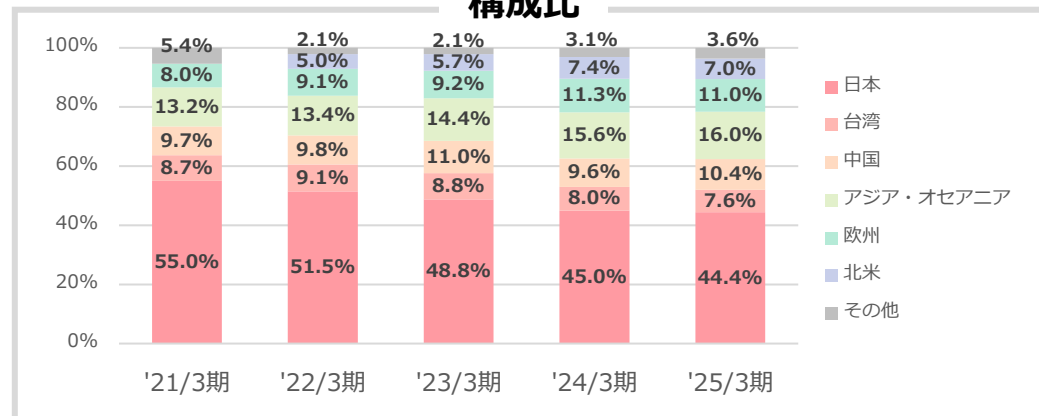
地域別売上高 及び 構成比（連結）

北米を除き、各地域で前期比増収 特にその他の中南米、中国の伸びが大きい

単位：百万円

	'24年3月期		'25年3月期			
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	前年同期増減額	前年同期増減率%
■ 日本	17,387	45.0	18,217	44.4	830	4.8
■ 台湾	3,080	8.0	3,111	7.6	30	1.0
■ 中国	3,704	9.6	4,275	10.4	571	15.4
■ その他アジア・オセアニア	6,041	15.6	6,535	16.0	493	8.2
■ 欧州	4,366	11.3	4,514	11.0	147	3.4
■ 北米	2,885	7.4	2,869	7.0	▲16	▲0.6
■ その他	1,187	3.1	1,482	3.6	295	24.9
海外計	21,266	55.0	22,789	55.6	1,522	7.2
合計	38,653	100.0	41,006	100.0	2,353	6.1

構成比



日本

「電子・半導体」「機械」向けが増加

中国

「電子・半導体」向けが増加

その他アジア・オセアニア

インドで「輸送機器」向けが増加

北米

「電子・半導体」「輸送機器」は増加、「機械」で減少

その他

中米等で「輸送機器」向けが増加

連結貸借対照表

投資有価証券の売却、長期借入金により現金及び預金が増加、設備投資により有形固定資産が増加

単位：百万円

資産の部	'24年3月末	'25年3月末	増減
現金及び預金	12,780	14,752	1,972
受取手形及び売掛金	10,387	10,038	▲348
棚卸資産	8,185	8,759	573
有形固定資産	26,655	28,845	2,189
無形固定資産	351	408	57
投資有価証券	13,164	10,778	▲2,386
その他	2,376	2,767	391
資産合計	73,901	76,351	2,449

負債の部	'24年3月末	'25年3月末	増減
支払手形及び買掛金	1,424	1,658	234
長期借入金	0	2,000	2,000
退職給付に係る負債	2,745	3,188	443
その他	5,739	5,924	185
負債合計	9,908	12,772	2,863

純資産の部	'24年3月末	'25年3月末	増減
純資産合計	63,993	63,579	▲414
負債純資産合計	73,901	76,351	2,449

連結キャッシュフロー計算書

設備投資により有形固定資産が増加したが、長期借入金、当期純利益の増加により、キャッシュは増加

	'24年3月末	'25年3月末	単位：百万円 増減
税金等調整前当期純利益	3,106	3,799	693
減価償却費	2,969	3,328	359
退職給付に係る負債の増減額（▲は減少）	▲436	▲347	89
売上債権の増減額（▲は減少）	52	549	496
棚卸資産の増減額（▲は減少）	▲684	▲397	286
法人税等の支払額	▲929	▲932	▲2
その他	▲1,238	▲234	1,004 ※
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	2,839	5,765	2,925
有形固定資産の取得/売却による支出/収入	▲4,246	▲4,991	▲745
投資有価証券の取得/売却による支出/収入	1,041	1,183	142
その他	▲299	▲12	287
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲3,505	▲3,820	▲315
長期借入れによる収入	0	2,000	2,000
自己株式の取得/売却による支出/収入	▲1,726	▲175	1,551
配当金の支払額	▲1,581	▲1,553	28
その他	187	▲484	▲671
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲3,121	▲212	2,908
現金及び現金同等物の期末残高	12,818	14,810	1,991

※主に、欧州新工場の未払金の増加

01 | 2025年3月期決算の概要

02 | 2026年3月期の見通し

03 | 中期経営計画の進捗

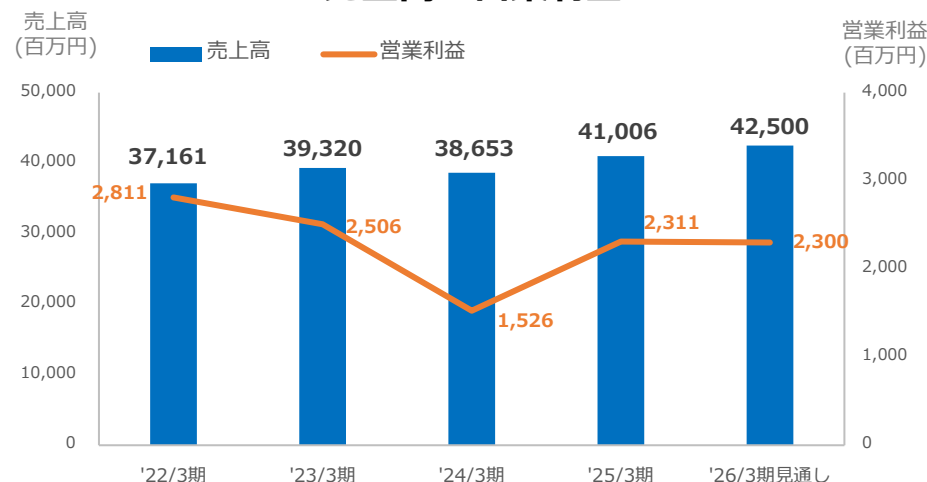
見通し概要（連結）

先行き不透明な市場環境の中、2026年3月期は次の飛躍に向けた1年とする

単位：百万円

	'25年3月期 上期実績	百分比%	'26年3月期 上期見通し	百分比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'25年3月期 通期実績	百分比%	'26年3月期 通期見通し	百分比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
売上高	20,688	100.0	20,100	100.0	▲588	▲2.8	41,006	100.0	42,500	100.0	1,493	3.6
営業利益	1,299	6.3	600	3.0	▲699	▲53.8	2,311	5.6	2,300	5.4	▲11	▲0.5
経常利益	1,628	7.9	800	4.0	▲828	▲50.9	3,070	7.5	2,600	6.1	▲470	▲15.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	1,129	5.5	400	2.0	▲729	▲64.6	2,493	6.1	2,200	5.2	▲293	▲11.8
JPY/USD							151.6	-	149.0			
為替レート JPY/EUR							163.8	-	162.0			
JPY/CNY							21.04	-	20.00			

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

増加要因

- 売上の増加 10億円
- 変動費率の減少 5億円

減少要因

- 退職給付費用の増加 8億円
- 人件費の増加 2億円
- 償却費の増加 2億円
- その他 3億円

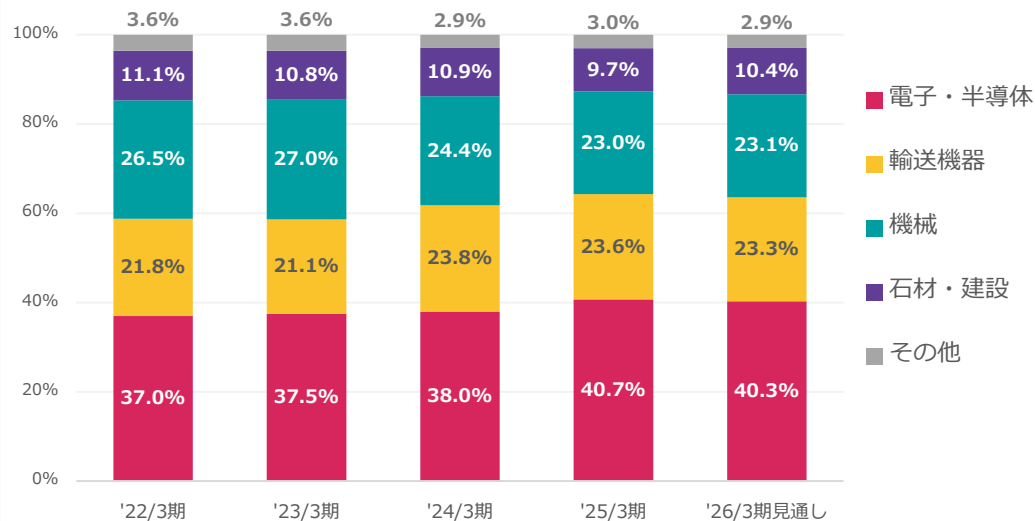
業界別売上高 及び 構成比見通し（連結）

下期に向けて特に電子・半導体の増加を見込み、通期では、全ての業界で増収を見込む

単位：百万円

	'25年3月期 上期実績	構成比%	'26年3月期 上期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'25年3月期 通期実績	構成比%	'26年3月期 通期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
電子・半導体	8,519	41.2	7,950	39.6	▲569	▲6.7	16,667	40.7	17,150	40.3	482	2.9
輸送機器	4,975	24.1	4,800	23.9	▲175	▲3.5	9,692	23.6	9,900	23.3	207	2.1
機械	4,631	22.4	4,600	22.9	▲31	▲0.7	9,430	23.0	9,800	23.1	369	3.9
石材・建設	1,934	9.3	2,100	10.4	165	8.6	3,975	9.7	4,400	10.4	424	10.7
その他	627	3.0	650	3.2	22	3.5	1,240	3.0	1,250	2.9	9	0.7
合計	20,688	100.0	20,100	100.0	▲588	▲2.8	41,006	100.0	42,500	100.0	1,494	3.6

構成比



電子・半導体

Si半導体向けを中心に販売が増加の見込み

輸送機器

自動車業種を中心に販売が増加の見込み

機械

軸受、超硬工具業種を中心に販売が増加の見込み

石材・建設

建設業種を中心に販売が増加の見込み

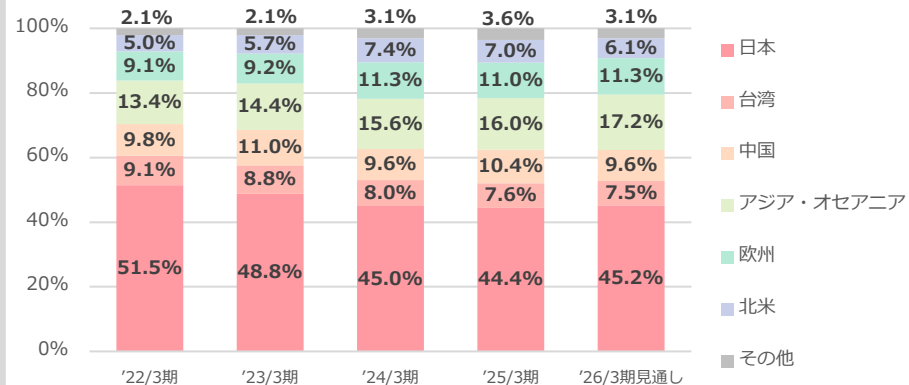
地域別売上高 及び 構成比見通し（連結）

日本、台湾、その他アジア・オセアニア、欧州での増収を見込む

単位：百万円

	'25年3月期 上期実績	構成比%	'26年3月期 上期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%	'25年3月期 通期実績	構成比%	'26年3月期 通期見通し	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
日本	9,037	43.7	9,200	45.8	162	1.8	18,217	44.4	19,200	45.2	982	5.4
台湾	1,627	7.9	1,500	7.5	▲127	▲7.8	3,111	7.6	3,200	7.5	88	2.8
中国	2,070	10.0	1,800	8.9	▲270	▲13.1	4,275	10.4	4,100	9.6	▲175	▲4.1
その他アジア・オセアニア	3,243	15.7	3,500	17.4	256	7.9	6,535	16.0	7,300	17.2	764	11.7
欧州	2,483	12.0	2,500	12.4	16	0.7	4,514	11.0	4,800	11.3	285	6.3
北米	1,449	7.0	1,000	5.0	▲449	▲31.0	2,869	7.0	2,600	6.1	▲269	▲9.4
その他	776	3.7	600	3.0	▲176	▲22.7	1,482	3.6	1,300	3.1	▲182	▲12.3
海外計	11,651	56.3	10,900	54.2	▲751	▲6.4	22,789	55.6	23,300	54.8	510	2.2
合計	20,688	100.0	20,100	100.0	▲588	▲2.8	41,006	100.0	42,500	100.0	1,493	3.6

構成比



日本

主に「電子・半導体」「機械」向けが増加の見込み

中国

「電子・半導体」向けが減少の見込み

その他アジア・オセアニア

インドネシアの資源探査、アジアの「電子・半導体」が増加の見込み

欧州

主に「電子・半導体」向けが増加の見込み

北米

「電子・半導体」向けが減少の見込み

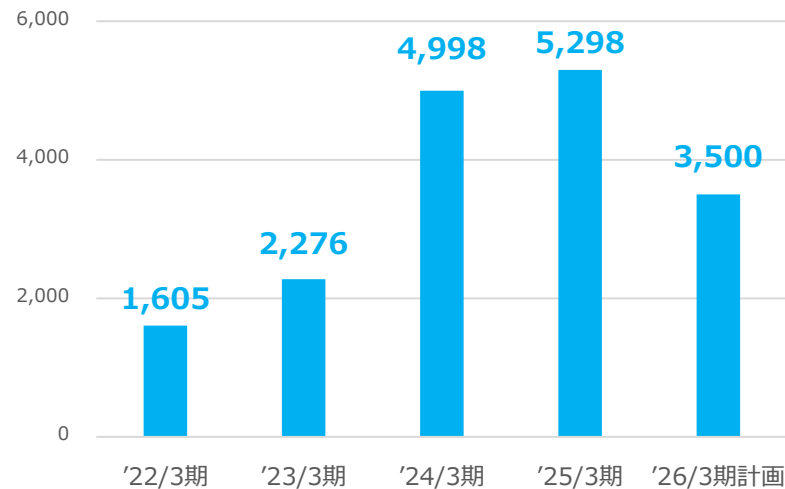
その他

中米等で「輸送機器」向けが減少の見込み

設備投資実績 及び 計画

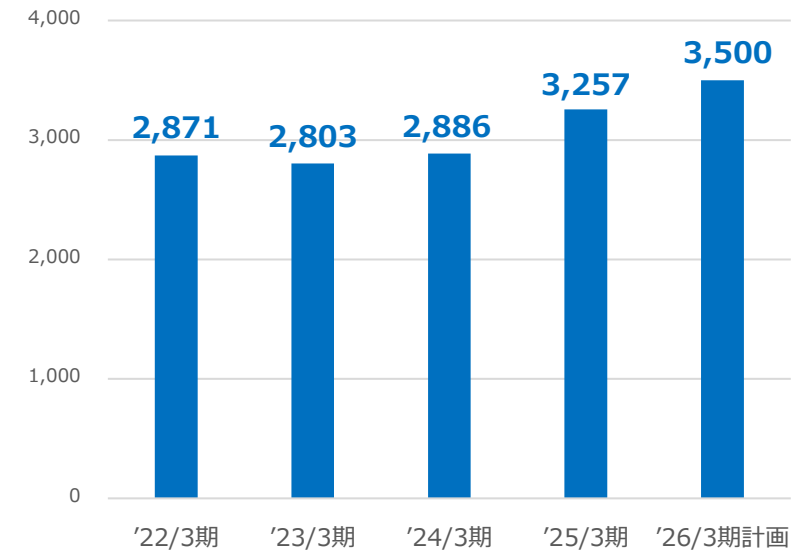
設備投資額

(百万円)



減価償却額

(百万円)



設備投資額

24年3月期、25年3月期は、電子・半導体向け工具の生産能力増強及び生産体制の再編で増加
26年3月期は、大きな投資の予定はなく減少の見込

01 | 2025年3月期決算の概要

02 | 2026年3月期の見通し

03 | 中期経営計画の進捗

▼「VISION2030」で目指す当社のあるべき姿 ▼

世界のモノづくりを支えるグローバルニッチトップメーカーへ

実現に向けた3つの要素

ブランド力の強化

市場浸透による拡販

成長分野/得意分野に注力

経営リソースの効果的な活用

先見的な製品開発

顧客ニーズの一步先へ

事業成長に向けた3つの重点施策

1

半導体注力

2

経営基盤強化

3

リソースの最適化

半導体注力

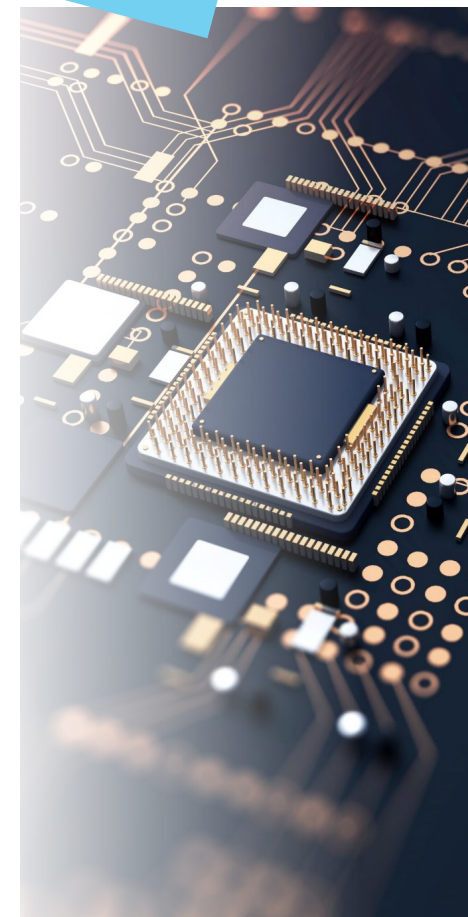
電子半導体セグメントに経営資源を集中させ、
高収益&業界のニッチトップを目指す

▶ 開発・製造

- 脱炭素にも貢献する需要拡大中のパワー半導体用SiC向け工具の開発
- 製造設備導入および工場再編による増産体制の構築
- 生産効率及び原価率の改善

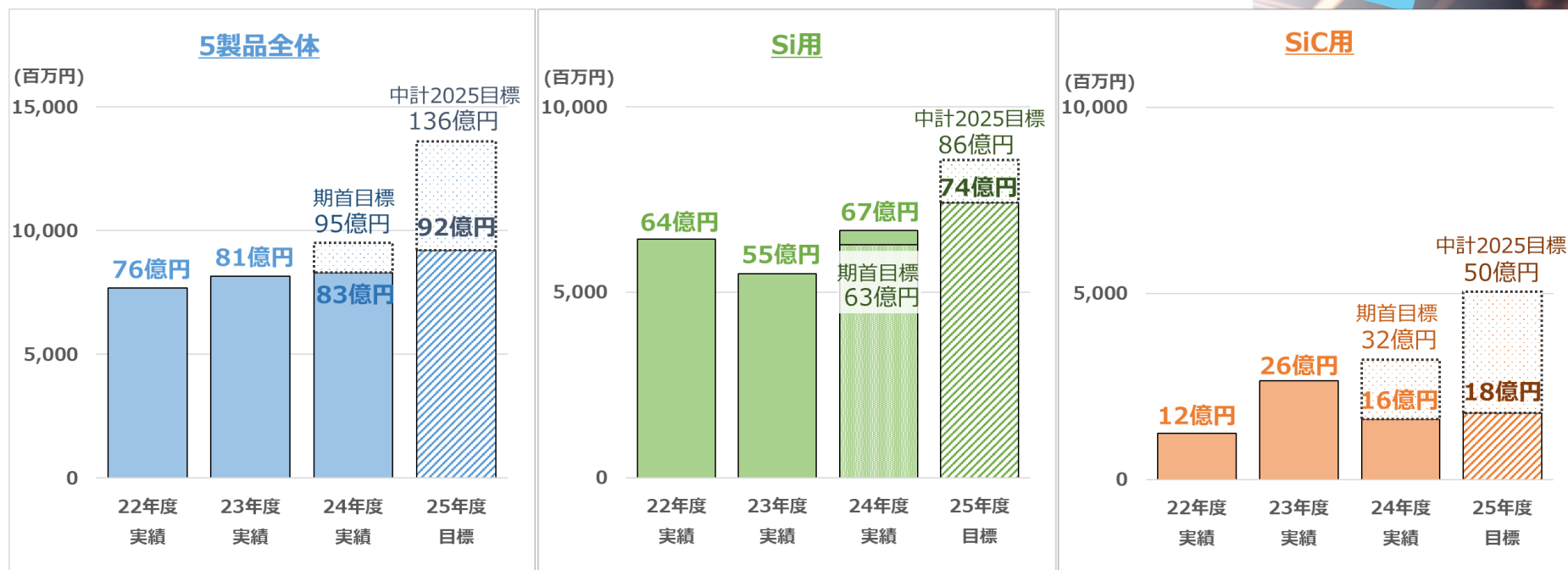
▶ 販売

- 高収益製品の拡販に注力
- 展示会の活用



半導体注力

注力5製品の売上実績と目標



注力5製品

電着ダイヤモンドワイヤ、外周面取り用ホイール、面研削用ホイール、CMPコンディショナ、ダイシングブレード

経営基盤強化

2

▶ ITシステム：「経営数値の見える化」と「業務の効率化」を実現する

- 基幹システム刷新 《27年度から運用開始予定》
- 営業SFA（営業支援システム）の活用

▶ グローバルガバナンス：中長期グループ経営方針に沿った経営の実現

- 海外子会社の事業計画に基づいた、組織・人材配置の最適化

▶ ブランディング：高品質で信頼できる旭ブランドのイメージ確立を目指す

- コーポレートサイトの刷新と活用《2024年4月リニューアル》
- ブランドアイデンティティの構築

▶ 人材育成：働きがいのある環境づくり

- 新人事制度による個々の特性を生かす
- エンゲージメント調査、360度評価の実施



リソースの最適化

事業領域整理と社内外リソースの最適化

▶ グループ内最適化

- 事業領域の分析と不採算部門の整理
- 生産能力増強（製造設備の導入、工場レイアウトの最適化）

▶ 外部リソースの活用

- 東京精密との合併会社「AAダイヤモンドテクノロジー株式会社」設立
- 製品の外部調達
- Tyrolit社との業務提携による相互製品供給

3



数値目標

市場環境の変化により中計3年目の目標を見直し

	2024年3月期 実績	2025年3月期 実績	2026年3月期 見通し	2026年3月期 中計目標
連結売上高（百万円）	38,653	41,006	42,500	49,000
連結営業利益（百万円）	1,526	2,311	2,300	4,900
連結営業利益率（%）	4.0	5.6	5.4	10.0
ROE（%）	3.4	4.0	3.5	6.0以上
PBR（倍）	0.80	0.67	—	1.0以上

中期経営計画期間中の資本政策および株主還元

適用期間 2024年3月期～2026年3月期

- 配当性向50%以上
- 総還元性向120%以上（3年平均）

ROE：6%以上 PBR：1倍以上

3カ年創出キャッシュ

160億円～

純利益

減価償却費

政策保有株式の売却

資産の効率化

成長投資：150億円

株主還元：90億円

実績

	2024年 3月期	2025年 3月期
配当性向	73.9%	62.0%
総還元性向	156%	70.1%
ROE	3.4%	4.0%
PBR	0.80倍	0.67倍
設備投資	50億円	53億円
株主還元	33億円	17億円



唯一無二
One and Only

世界の変化を先取りし、革新的技術とグローバルな組織力で、当社にしかできない製品・ソリューションを提供し続けます。

永続的な成長
Eternal Growth

モノづくりに携わる全世界のお客様から最も頼られる存在となり、永続的に成長する企業を目指します。

働きがい
Job Satisfaction

仕事のやりがいを個々の成長に結び付けて持ち味を引き出し、全従業員がいきいきと働く企業を目指します。

- ・本資料には、過去の事実以外に今後の業績見通しや計画が記載されていますが、これらの見通しや計画は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・2024年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

